
Formation des défauts géométriques des wafers de silicium découpés avec un fil à abrasifs fixes

JNPV2017

Michel LY
Directeur R&D
Thermocompact

Résumé

Les wafers de silicium découpés avec un fil à abrasifs fixes sont affectés par des défauts géométriques.

Ces défauts résultent principalement de la déviation du trait de scie en dehors du plan de découpe prévu.

Un modèle qualitatif relie les variations du pouvoir de coupe du fil avec les déviations du trait de scie.

Une solution pour limiter les écarts de trajectoire est proposée. Cette solution a fait l'objet d'une demande de brevet.

Figure

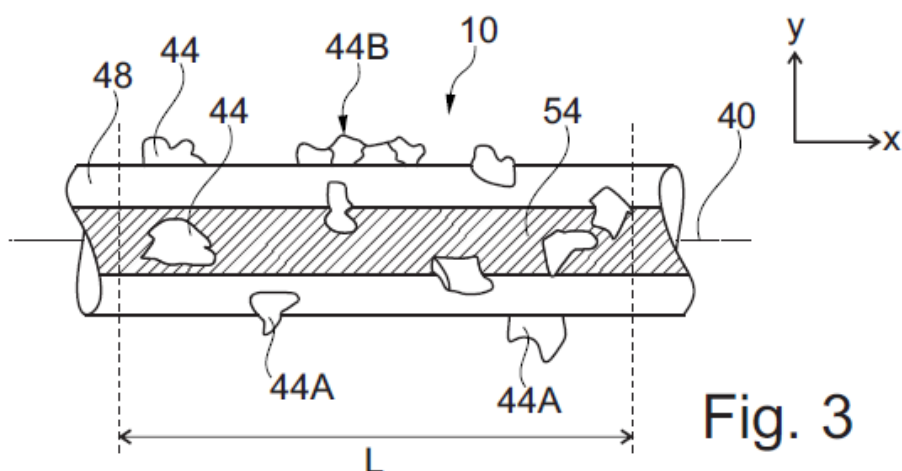


Fig. 3